

公益社団法人砥粒加工学会 研磨の基礎科学とイノベーション化専門委員会
第26回 KENMA 研究会
【対面再開 KENMA 研究会—KENMA に対する多様な取り組みと情報交換会—】開催ご案内
主催：(公社)砥粒加工学会 研磨の基礎科学とイノベーション化専門委員会

2015年2月、(公社)砥粒加工学会に「研磨の基礎科学とイノベーション化専門委員会」が設立されました。本専門委員会では、「温故知新」の名言に倣い、研磨の歴史・ノウハウ・技術伝承の在り方を探り、そこから次代に向けた課題の明確化とその解決手法開発に取り組むことを目指します。第26回研究会を【対面再開 KENMA 研究会—KENMA に対する多様な取り組みと情報交換会—】と題して開催いたします。多数の皆様のご参加をお待ちしています。



日時：2023年7月4日(火) 13:00～19:00
(研究会・・・13:00～16:10, 拡大技術交流会・・・17:00～19:00)

開催場所：金沢工業大学 KIT 虎ノ門大学院 (愛宕東洋ビル 13F)
【「虎ノ門ヒルズ」の隣のビルです】
〒105-0002 東京都港区愛宕 1-3-4 愛宕東洋ビル 11F&12F&13F
(TEL : 03-5777-2227)

http://www.kanazawa-it.ac.jp/about_kit/access.html#anchor06 (アクセスマップ)
東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩8分
都営地下鉄三田線 御成門駅 徒歩8分 JR 山手線 新橋駅 徒歩15分



内容：

【テーマ：対面再開 KENMA 研究会—KENMA に対する多様な取り組みと情報交換会—】

- 13:00～13:05 開会挨拶 委員長 畝田道雄 (金沢工業大学)
- 13:05～15:30 話題提供
- <技術講演>
- 1) 13:05～13:45 金属・金型の表面処理
ユニテック・ジャパン株式会社 営業部 次長 柳谷良行 氏
日本スピードシヨア株式会社 営業部 取締役 部長 新保高士 氏
- 2) 13:45～14:15 DEM を用いたバレル研磨シミュレーション
株式会社チップトン 開発部機械開発課 課長 伊東 稔 氏
- 14:15～14:30 休憩
- 3) 14:30～15:00 機械加工設備内に形成するバイオフィルム (ぬめり) の対策について
株式会社共生環境技術研究所 代表取締役 山田博子 氏
(東北大学大学院医工学研究科 リサーチフェロー)
- 4) 15:00～15:30 機械加工のイノベーションを実現するモニタリング技術とその活用
株式会社山本金属製作所 技術開発部 課長 山本隆将 氏
- 15:30～16:00 名刺交換会・情報交換会
(飲食無しとなりますが、講演会場で講演者を含めた参加者同士の名刺交換や情報交換の場を設けます)
- 16:00～16:10 閉会の挨拶 副委員長 會田英雄 (長岡技術科学大学)
- 17:00～19:00 拡大技術交流会 (会場を移して実施します…会場は現在調整中です。)

参加費：5,000 円。事前振込みをお願い致します。

※研究会 (講演会) 終了後には場所を移し「拡大技術交流会 (会費：5,000 円)」を開催します。※

定員：80 名 (先着順/会場人数制限のため上限を設けています)

注意事項

- 予稿集は PDF で配信いたします (ダウンロードアドレスを配信します)。なお、研究会終了後の再ダウンロード (再配信) に関する対応はできませんのでご注意ください。
- 参加申込み頂いた方には別途、事前振込みの請求書 (PDF ファイル) をメール返信でご案内をします。振込みが確認できましたら、予稿集のダウンロードアドレスを配信させていただきます。
- 原則、領収書の発行はございません。
金融機関発行の振込明細票等をもって領収書に代えさせていただきます。
- 研究会は 13:00～開始しますが、受付は 12:30～実施します。
- 事前参加受付をして頂いた方のみ、参加できるようにします。(当日の参加申込みには対応できません。)
- 写真撮影や録音・録画はお控えください。
- 久しぶりの対面開催になりますのでタイムコントロールが難しく、多少の時間延長を生じる可能性がありますこと、あらかじめご理解とご了承のほどお願い申し上げます。
- キャンセルされる場合には参加費を請求する場合があります。

参加申込〆切：2023年6月26日（月）〆切を延長しました

参加申込先並びに問合せ先：金沢工業大学 精密工学（畝田）研究室 KENMA 研究会事務局 竹澤瑛里子

TEL：076-274-8066 E-mail：une-asst@neptune.kanazawa-it.ac.jp ※出来る限りメールでお申し込みください※

KENMA 研究会「第26回研究会」 参加申込書

氏名			
勤務先・所属			
参加内容 (参加されるものに○を付けて下さい)	研究会（会費：5,000円）		拡大技術交流会（会費：5,000円）
連絡先	住所		
	TEL		
	E-mail		